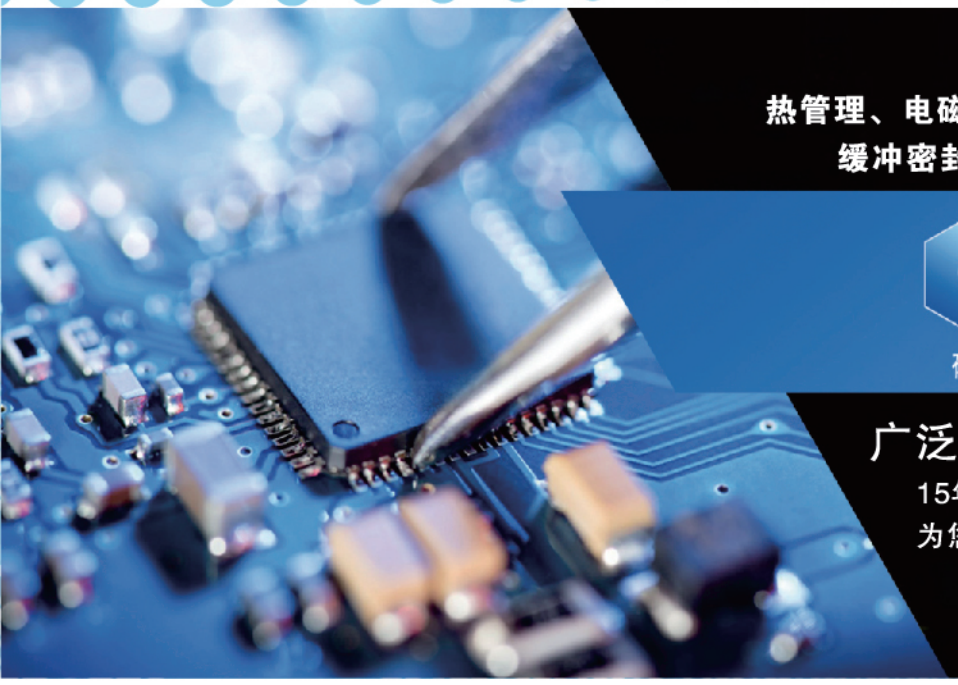
佳利品导热
Jia Li Pin TIM

— 热解决方案材料提供商 —



热管理、电磁屏蔽管理及
缓冲密封管理的材料生产提供商

研发　生产　销售

广泛应用于电子电器行业

15年行业经验
为您提供优质的服务有产品

昆山佳利品导热材料有限公司

KUNSHAN JIALIPIN THERMAL MATERIALS CO., LTD

Company profile
公司简介

昆山佳利品导热材料有限公司（佳利品导热，GLP TIM）创立于2022年，座落于中国百强县市之首的昆山市，是一家从事热管理、吸波管理及缓冲密封管理的材料生产提供商。有着十多年的研发销售经验团队提供服务支持，高品质/高服务/高效率是我们的服务宗旨。

目前公司的产品有GLP-600系列导热垫片、 GFP导热凝胶、GAP系列导热吸波垫片以及PCM系列相变储热系列产品等全系列界面型导热材料；同时具有缓冲发泡密封型硅胶材料，全方位为客户提供整体解决方案。

这些材料广泛应用于通信设备、汽车电子、新能源、安防、电源、医疗设备、及智能穿戴等等各类消费类3C电子行业，作为其优异的导热散热、电磁屏蔽及缓冲密封解决方案提供商。



目录Contents

一、导热垫片系列

1.导热垫片GLP-600系列 ---------- 01
2.高强度GLP-600复合材料系列 ---------- 02
3.高强度缓冲阻燃垫片 GLP-600 H05V0 ---------- 03
4.超低挥发光学元器件激光雷达用导热垫片GLP-600 K20L ---------- 04
5.超低挥发光学元器件激光雷达用导热垫片GLP-600 K50L ---------- 05
6.低密度 低介电常数 军工航天用导热垫片GLP-600 K30 Q ---------- 06
7.低密度 低介电常数 军工航天用导热垫片 GLP-600 K50 Q ---------- 07
8.超软导热系数垫片 GLP-600 K80-S35 ---------- 08
9.超软导热系数垫片 GLP-600 K130-S45 ---------- 09

二、导热绝缘片系列

1.高导热绝缘 军工 汽车电子 家电 GLP-600 G2000绝缘片 ---------- 10
2.GSP-900系列绝缘片 ---------- 11

三、导热凝胶系列

1、单组份 1-12W ---------- 12-13
2、双组分 1-10W ---------- 14-15

四、导热硅脂系列

GG-100系列 1-7W ---------- 16

五、导热罐封胶

GFP-200系列 1-5W ---------- 17

六、导热双面胶系列

GFD-300系列 ---------- 18

七、导热吸波GAP 400系列

1.GAP-600 K30 ---------- 19
2.GAP-600 K40 ---------- 20

导热垫片GLP-600系列

GLP-600导热填充垫片用于连接热元器件与机壳或散热片组装之间的界面，以提高系统整体传热传递效果。兼具导热性如软性，降低机械应力，保持优异的导热效能。高品导热界面填充产品线包含众多功能产品，包括超薄，高形变，超软，超低挥发，低渗油，高导热等系列。

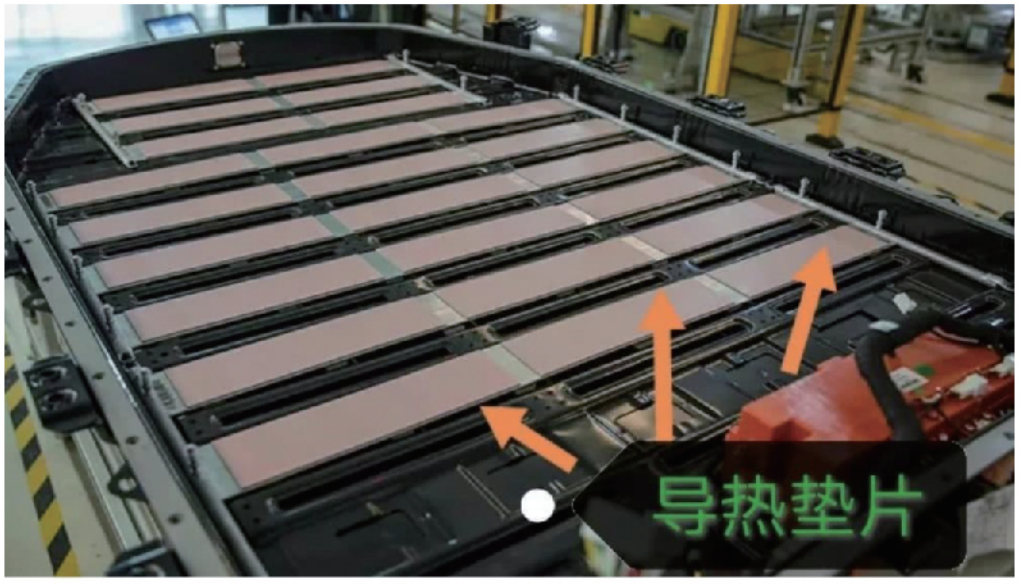
性能参数 / 产品型号	颜色	厚度 (mm)	玻纤增强	导热率 (W/m·K)	密度 (g/cm3)	硬度 (Shore 00)	阻燃等级 (UL94)	温度适用范围 (℃)	耐电压 (KV/mm)	电阻率 (Ω·cm)
GLP -600 10系列	ALL	0.20 ~15.0	可含玻纤	1	2	30~70	V-0	-40~150	>6	>9.6 x 10^{12}
GLP -600 15系列	ALL	0.20 ~ 15.0		1.5	2.2	30~70				
GLP -600 20系列	ALL	0.25 ~ 15.0		2	2.4	35~70				
GLP -600 30系列	ALL	0.25 ~ 15.0		3	2.7	40~70				
GLP -600 40系列	ALL	0.3 ~ 10.0		4	2.9	50~70				
GLP -600 50系列	灰色	0.3 ~ 10.0		5	3	50~70				
GLP -600 60系列	灰色	0.3 ~ 10.0		6	3.1	55~70				
GLP -600 80系列	灰色	0.5 ~ 10.0		8	3.2	55~70				
GLP -600 120系列	灰色	0.5-10.0		12	3.3	55~70				
GLP -600 150系列	灰色	0.5-10.0		15	3.3	55~70				

高强度GLP-600复合材料

新能源电池汽车电子用导热材料

GLP-600复合材料系列产品具有高变形弹性和良好压缩比，适用于大型结构设计公差，产品可以低密度设计，满足汽车零件行业轻量化的设计趋势要求，采用特殊超薄玻璃纤维或者PI膜双层结构，增加可操作性耐用性，增加产品强度耐摩擦耐震荡，无论是冲压打孔，条形，畸形设计不会破碎变形。

产品型号 / 性能参数	GLP -600	GLP -600	GLP -600	GLP -600
	15G系列	15P系列	15HS高强度系列	1050A锯齿状系列
颜色	粉红+灰色	黄色+灰色	ALL	灰色
厚度 (mm)	0.5 ~15.0	0.30 ~ 15.0	0.20 ~ 15.0	0.5 ~ 2.0
复合材料	玻纤绝缘片	PI绝缘膜	无	无
导热率 (W/m·K)	1.5~2.0	1.5~2.0	1.5	1
密度 (g/cm3)	2.0	2.0	2.0	2.0
硬度 (Shore 00)	30~70	30~70	50~70	40~70(A)
拉伸强度 (Mpa)	>5	>2	>0.4	>1.5
阻燃等级 (UL94)	V-0			
温度适用范围(℃)	-45~150	-45~150	-45~150	-45~150
耐电压 (KV/mm)	>6			
电阻率(Ω·cm)	$>9.6 \times 10^{13}$			



高强度缓冲阻燃垫片 GLP-600 H05V0

新能源电池汽车电子用导热材料

产品 外形及特点 Appearance and features



- 间隙填充能力佳，缓冲垫片
- 导热系数1.0W/mk
- 高拉伸强度，及耐磨，对折不损坏特性
- 阻燃V-0，表面微粘，防尘，方便使用

基本特性	典型值		测试标准		
颜色	ALL		目测		
厚度（mm）	0.2~10.0		目测		
基材			N/A		
密度（g/cm^3）	2.2		ASTMD792		
硬度（Shore A）	40-50		ASTMD2240		
拉伸强度Mpa	5		ASTMD412		
击穿强度（KV/mm）	≥6		ASTMD149		
体积电阻率（Ω.cm）	$>10^{12}$		ASTMD257		
阻燃等级	V-0		UL 94		
可提取硅（渗油率）（%）	≤0.3		ASTMG120-01		
可持续工作温度（℃）	-40 to 180		N/A		
导热性能					
导热率（W/m-k）	1.0		ASTMD5470		
热阻&压缩 v.s. 压力 （厚度1mm样片为参考）					
压力（Psi）	10	20	30	40	50
热阻（℃-in^2/W）	0.68	0.62	0.54	0.48	0.45
压缩比例（%）	38%	52%	62%	70%	76%

GLP-600 H05V0是一款高拉伸强度的缓冲阻燃材料，具有良好的拉伸强度性能，耐磨性能及对折性能，及良好的导热性能并阻燃等级达到94V0。目前应用在新能源系统中可替代普通导热材料，起到可靠的产品使用。也可作为多用途的邦定硅胶材料，主要使用在TFT-LCD的组装工程，并把Flexible PCB压缩到Glass pannel的工程中起到Heating tool的热传导和缓冲作业，所以不会给PCB和Glass panel 在组装过程中热和压力作用下带来损坏，可提供不同厚度的材料，易于加工成所需的尺寸。

应用

- 新能源汽车
- 通信设备
- 消费电子
- LED灯具
- 安防设备

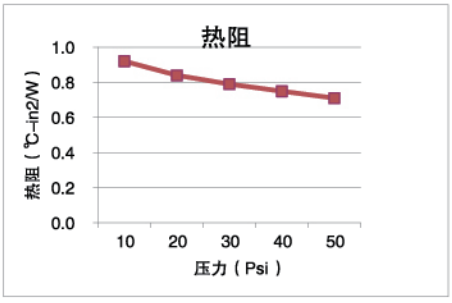
操作说明

本产品使用时需把一面的透明PET保护膜或者蓝色网格膜给揭掉，采用手工或者治具进行产品定位，使产品平整的固定在功率器件表面。

产品配置

- 可根据客户要求进行裁切
- 标准尺寸200*400mm，也可根据顾客要求定制
- 仓储最佳有效期：12个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

压力V.S.热阻&压缩率曲线图



GLP-600 K20L

超低挥发光学元器件激光雷达用导热垫片

产品 外形及特点
Appearance and features



- 间隙填充能力佳，低热阻
- 导热系数2.0W/mk
- 低挥发，低出油
- UL94V0阻燃等级
- 双面微粘、易操作

基本特性	典型值		测试标准		
颜色	白色		目测		
厚度（mm）	0.25~8.0		目测		
基材	/		N/A		
密度（g/cm^3）	2.65		ASTMD792		
硬度(Shore 00)	30~50		ASTMD2240		
挥发率（%）	0.02%		130℃&24H		
D3~D12	<50ppm		硅氧烷含量		
击穿强度(KV/mm)	>6		ASTMD149		
体积电阻率(Ω.cm)	4.2x10^{12}		ASTMD257		
阻燃等级	V-0		UL 94		
可持续工作温度（℃）	-40 to 150		N/A		
导热性能					
导热率(W/m-k)	2.0		ASTMD5470		
热阻&压缩 v.s. 压力 （厚度1mm样片为参考）					
压力(Psi)	10	20	30	40	50
热阻(℃-in^2/W)	0.94	0.84	0.76	0.66	0.62
压缩比例（%）	16.0%	22.0%	28.0%	33.0%	36.0%

GLP-600 K20L是一款低挥发/低出油导热材料，具有良好的导热性能。在相对较低的压力下就可以实现低界面热阻性能,同时具有低挥发低出油功能可应用与对硅敏感部件。

应用于功率器件与散热铝片或机器外壳间，可以有效的排除空气，达到很好的填充效果。

应用

- 新能源汽车
- 通信设备
- 消费电子
- LED灯具
- 安防设备

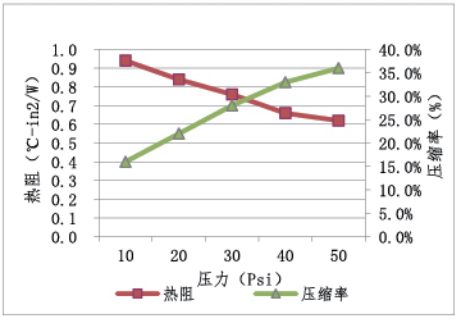
操作说明

本产品使用时需把一面的保护膜给揭掉（一般是揭掉蓝色网纹膜，即：离型力小的这面），采用手工或者治具进行产品定位，使产品平整的固定在功率器件表面。

产品配置

- 可根据客户要求进行裁切
- 标准卷材尺寸为 200mm *400mm , 也可根据顾客要求定制
- 仓储最佳有效期：12个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

压力V.S.热阻&压缩率曲线图



GLP-600 K50L

超低挥发光学元器件激光雷达用导热垫片

外形及特点
Appearance and features



- 间隙填充能力佳，低热阻
- 导热系数5.0W/mk
- 低挥发，低出油
- UL94V0阻燃等级
- 双面微粘、易操作

基本特性	典型值	测试标准
颜色	白色	目测
厚度（mm）	0.3~15.0	游标卡尺
基材	/	N/A
密度（g/cm³）	3.1	ASTMD792
硬度（Shore 00）	50-60	ASTMD2240
挥发率（%）	0.02%	130℃&24H
D3~D12	<50ppm	硅氧烷含量
击穿强度（KV/mm）	>6	ASTMD149
体积电阻率（Ω.cm）	$4.2x10^{12}$	ASTMD257
阻燃等级	V-0	UL 94
可持续工作温度（℃）	-40 to 150	N/A
导热性能		
导热率（W/m-k）	5.0	ASTMD5470
热阻&压缩 v.s. 压力	（厚度1mm样片为参考）	
压力（Psi）	10 / 20 / 30 / 40 / 50	
热阻（℃-in²/W）	0.35 / 0.32 / 0.30 / 0.28 / 0.27	
压缩比例（%）	15.0% / 21.0% / 26.0% / 29.0% / 32.0%	

GLP-600 K50L是一款低挥发/低出油导热材料，具有良好的导热性能。在相对较低的压力下就可以实现低界面热阻性能,同时具有低挥发低出油功能可应用与对硅敏感部件。

应用于功率器件与散热铝片或机器外壳间，可以有效的排除空气，达到很好的填充效果。

应用

- 安防设备
- 汽车部件
- 消费电子
- LED灯具
- 通信设备

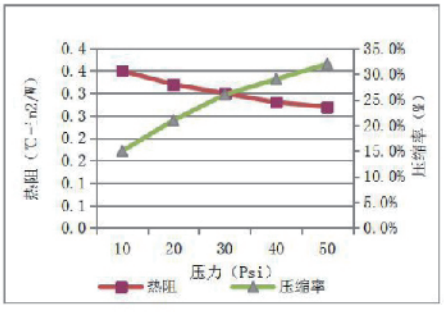
操作说明

本产品使用时需把一面的保护膜给揭掉（一般是揭掉蓝色网纹膜，即：离型力小的这面），采用手工或者治具进行产品定位，使产品平整的固定在功率器件表面。

产品配置

- 可根据客户要求进行裁切
- 标准卷材尺寸为 200mm *400mm，也可根据顾客要求定制
- 仓储最佳有效期：12个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

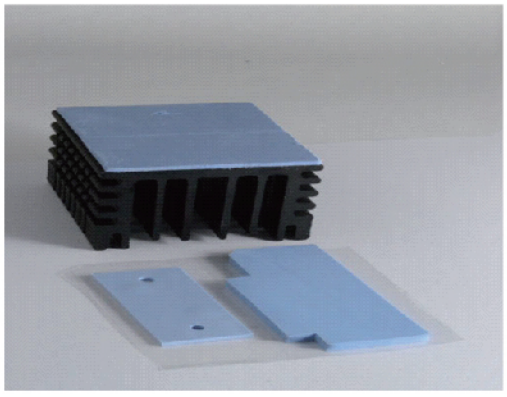
压力V.S.热阻&压缩率曲线图



GLP-600 K30 Q

低密度 低介电常数 军工航天用导热垫片

产品 外形及特点
Appearance and features



- 间隙填充能力佳，低热阻
- 导热系数3.0W/mk
- 低密度，低介电常数
- UL94V0阻燃等级
- 双面微粘、易操作

基本特性	典型值		测试标准		
颜色	蓝紫色		目测		
厚度（mm）	0.25~8.0		目测		
基材	/		N/A		
密度 (g/cm ^{3})	1.5		ASTM D792		
硬度(Shore 00)	25–45		ASTM D2240		
介电常数	<4		1GHZ		
击穿强度(KV/mm)	>6		ASTM D149		
体积电阻率(Ω.cm)	4.2x10^{12}		ASTM D257		
阻燃等级	V–0		UL 94		
可持续工作温度（℃）	- 40 to 200		N/A		
导热性能					
导热率(W/m–k)	3.0		ASTM D5470		
热阻&压缩 v.s. 压力	（厚度1mm样片为参考）				
压力(Psi)	10	20	30	40	50
热阻(℃–in^2/W)	0.64	0.56	0.50	0.46	0.42
压缩比例（%）	16.0%	24.0%	30.0%	36.0%	40.0%

GLP–600 K30 Q 是一款氮化硼陶瓷粉体填充的高导热材料，具有良好的导热性能和极低的密度。在相对较低的压力下就可以实现低界面热阻性能。应用于功率器件与散热铝片或机器外壳间，可以有效的排除空气，达到很好的填充效果。

应用

- 通信设备
- 汽车部件
- 消费电子
- LED灯具
- 安防设备

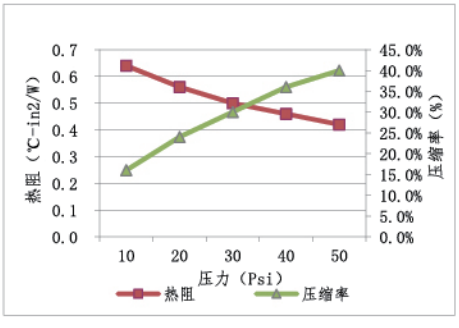
操作说明

本产品使用时需把一面的保护膜给揭掉（一般是揭掉蓝色网纹膜，即：离型力小的这面），采用手工或者治具进行产品定位，使产品平整的固定在功率器件表面。

产品配置

- 可根据客户要求进行裁切
- 标准尺寸为 460mm *460mm, 也可根据顾客要求定制
- 仓储最佳有效期：18个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

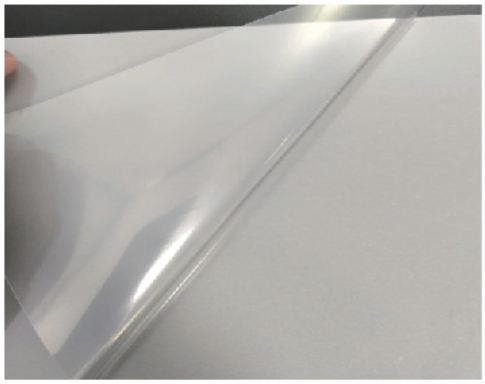
压力V.S.热阻&压缩率曲线图



GLP-600 K50 Q

低密度 低介电常数 军工航天用导热垫片

产品 外形及特点 Appearance and features



- 间隙填充能力佳，低热阻
- 导热系数5.0W/mk
- 中等硬度可压缩，低介电常数
- UL94V0阻燃等级
- 双面微粘、易操作

基本特性	典型值	测试标准
颜色	灰色	目测
厚度（mm）	0.5~5.0	目测
基材	/	N/A
密度（g/cm^3）	2.2	ASTMD792
硬度(Shore 00)	60	ASTMD2240
介电常数	<4	1GHZ
击穿强度(KV/mm)	>6	ASTMD149
体积电阻率(Ω.cm)	$>4.2x10^{12}$	ASTMD257
阻燃等级	V-0	UL 94
可持续工作温度（℃）	-40 to 200	N/A
导热性能		
导热率(W/m-k)	5.0	ASTMD5470

热阻&压缩 v.s. 压力 （厚度1mm样片为参考）					
压力(Psi)	10	20	30	40	50
热阻($°C-in^2/W$)	0.35	0.32	0.30	0.28	0.27
压缩比例（%）	15.0%	21.0%	26.0%	29.0%	32.0%

GLP-600 K50 是一款氮化硼陶瓷填充高导热材料，具有良好的导热性能。具有较低得密度同时导热又高得产品，在相对较低的压力下就可以实现低界面热阻性能。应用于功率器件与散热铝片或机器外壳间，可以有效的排除空气，达到很好的填充效果。

应用

- 安防设备
- 汽车部件
- 消费电子
- LED灯具
- 通讯设备

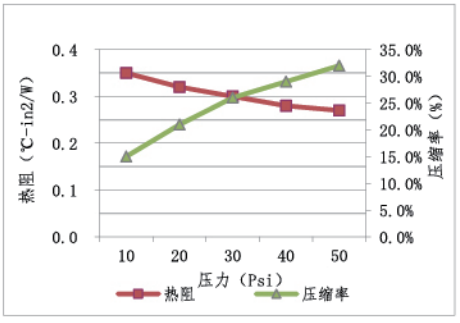
操作说明

本产品使用时需把一面的保护膜给揭掉（一般是揭掉蓝色网纹膜，即：离型力小的这面），采用手工或者治具进行产品定位，使产品平整的固定在功率器件表面。

产品配置

- 可根据客户要求进行裁切
- 标准卷材尺寸为 460mm *460mm , 也可根据顾客要求定制
- 仓储最佳有效期：12个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

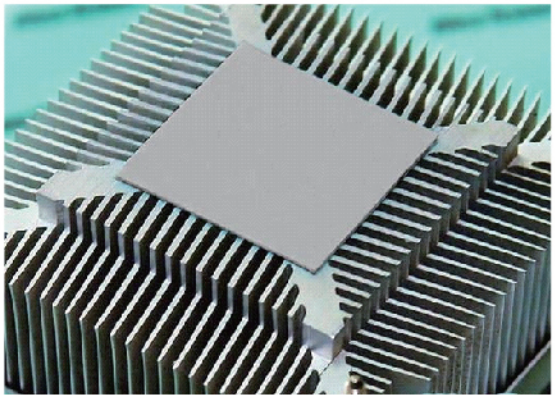
压力V.S.热阻&压缩率曲线图



GLP-600 K80 S35

超软凝胶导热垫片

产品 外形及特点 Appearance and features



- 超软导热系数，低热阻
- 导热系数8.0W/mk
- 凝胶垫片可压缩
- UL94V0阻燃等级
- 双面微粘、易操作

基本特性	典型值	测试标准
颜色	灰白色	目测
厚度（mm）	0.5~15.0	目测
基材	/	N/A
密度（g/cm^3）	3.3	ASTMD792
硬度(Shore 00)	35	ASTMD2240
拉伸强度Mpa	0.15	ASTMD412
击穿强度(KV/mm)	>6	ASTMD149
体积电阻率(Ω.cm)	>4.2x10^{11}	ASTMD257
阻燃等级	V-0	UL 94
可持续工作温度（℃）	-40 to 125	N/A
导热性能		
导热率(W/m-k)	8.0	ASTMD5470
热阻&压缩 v.s. 压力	（厚度1mm样片为参考）	

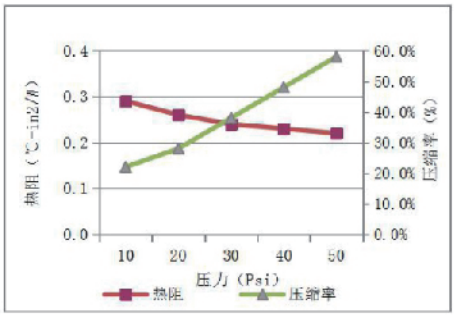
压力(Psi)	10	20	30	40	50
热阻(℃-in^2/W)	0.29	0.26	0.24	0.23	0.22
压缩比例（%）	22.0%	28.0%	38.0%	48.0%	58.0%

GLP-600 K80 S35是一款超软且高导热材料，具有极佳的导热性能。在相对较低的压力下就可以实现低界面热阻性能。应用于功率器件与散热铝片或机器外壳间，可以有效的排除空气，达到很好的填充效果。

应用

- 通信设备
- 汽车部件
- 消费电子
- LED灯具
- 安防设备

压力V.S.热阻&压缩率曲线图



操作说明

本产品使用时需把一面的保护膜给揭掉（一般是揭掉蓝色网纹膜，即：离型力小的这面），采用手工或者治具进行产品定位，使产品平整的固定在功率器件表面。

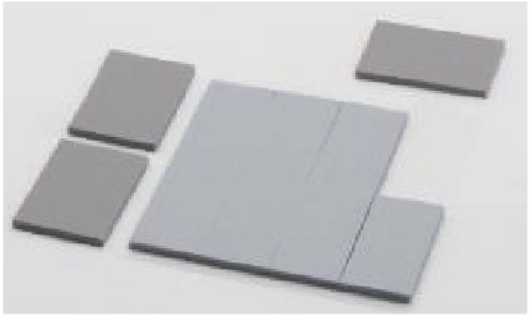
产品配置

- 可根据客户要求进行裁切
- 标准卷材尺寸为 200mm *400mm，也可根据顾客要求定制
- 仓储最佳有效期：12个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

GLP-600 K130 S45

超软凝胶导热垫片

产品 外形及特点 Appearance and features



- 超软导热系数，低热阻
- 导热系数13W/mk
- 超软硬度可压缩
- UL94V0阻燃等级
- 双面微粘、易操作

基本特性	典型值	测试标准
颜色	灰色	目测
厚度（mm）	0.5–10.0	目测
基材	/	N/A
密度（g/cm³）	3.5	ASTMD792
硬度(Shore 00)	45	ASTMD2240
拉伸强度 Mpa	/	ASTMD412
击穿强度(KV/mm)	>6	ASTMD149
体积电阻率(Ω.cm)	$>4.2x10^{12}$	ASTMD257
阻燃等级	V-0	UL 94
可持续工作温度（℃）	-40 to 150	N A
导热性能		
导热率(W/m-k)	13	ASTMD5470
热阻&压缩 v.s. 压力	（厚度1mm样片为参考）	

压力(Psi)	10	20	30	40	50
热阻(℃-in²/W)	0.25	0.22	0.20	0.18	0.17
压缩比例（%）	22.0%	28.0%	38.0%	48.0%	58.0%

GLP-600 K130 S45是一款超软且高导热材料，具有极佳的导热性能。在相对较低的压力下就可以实现低界面热阻性能。应用于功率器件与散热铝片或机器外壳间，可以有效的排除空气，达到很好的填充效果。

应用

- 通信设备
- 汽车部件
- 消费电子
- LED灯具
- 安防设备

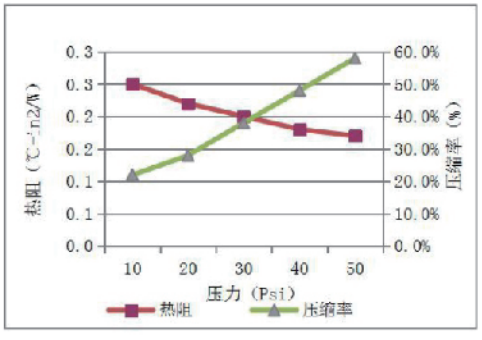
操作说明

本产品使用时需把一面的保护膜给揭掉（一般是揭掉蓝色网纹膜，即：离型力小的这面），采用手工或者治具进行产品定位，使产品平整的固定在功率器件表面。

产品配置

- 可根据客户要求进行裁切
- 标准卷材尺寸为 200mm *400mm , 也可根据顾客要求定制
- 仓储最佳有效期：12个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

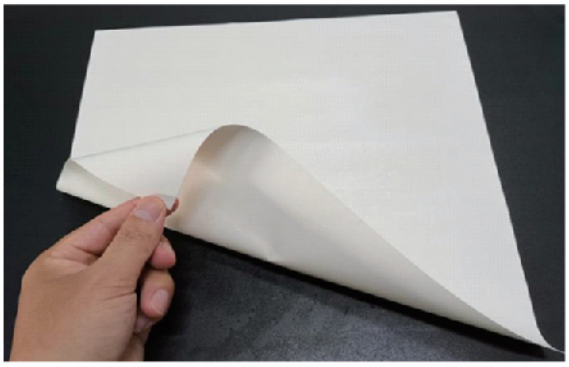
压力V.S.热阻&压缩率曲线图



GLP-600 G2000

高导热绝缘 军工 汽车电子 家电

产品 外形及特点 Appearance and features



基本特性	典型值 GGP-600 G2000	测试标准
颜色	白色	目测
厚度（mm）	0.25/0.38/0.5	目测
基材	玻璃纤维	N/A
密度（g/cm^3）	2.0	ASTM D792
硬度（Shore A）	85-90	ASTM D2240
拉伸强度Mpa	>2	ASTM D412
击穿电压（KV）	>4	ASTM D149
体积电阻率（Ω.cm）	$5.4x10^{11}$	ASTM D257
阻燃等级	V-0	UL 94
可持续工作温度（℃）	-40 to 180	N/A
导热性能		
导热率（W/m-k）	3.5	ASTMD5470

热阻&压缩 v.s. 压力 （以G2000，0.25mm样片为参考）							
压力（Psi）	10	20	30	40	50	60	70
热阻（$℃-in^2/W$）	0.5	0.48	0.44	0.41	0.38	0.35	0.32
压缩比例（%）	7.0%	9.0%	11.0%	12.0%	13.0%	14.0%	15.0%

- 高导热，低热阻
- 导热系数3.5W/mk
- 高击穿电压，高强度
- UL94V0阻燃等级
- 低安装应力、易操作
- 玻纤基材，可单面背胶

GLP-600 G2000系列是一款导热绝缘垫片材料，具有良好的绝缘性能和导热性能。
GLP-600 G2000是在以玻璃纤维基材增强的导热硅橡胶而制成的导热绝缘片产品；同时具备导热性能和高耐压绝缘性能。主要应用于发热半导体器件和散热基板之间，起导热和绝缘作用。

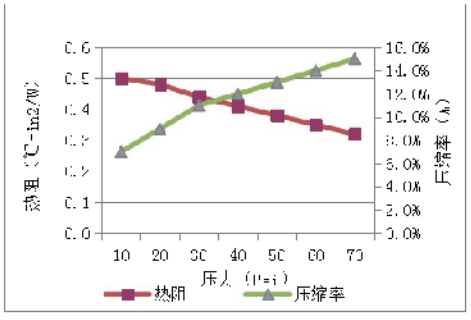
应用

- 通信设备
- 汽车部件
- 消费电子
- LED灯具
- 安防设备

操作说明

可依客户具体要求模切成所需要各类形状。各类应用的目标热源器件（通常是半导体器件，如电源标准器件：TO-220和TO-247等）在组装过程中绝大多数采用弹簧卡夹或螺钉安装，只要在组装过程中施加一个适当的安装所需要的力，使其固定在热源器件和散热板之间就可以实现有效的导热效果。

压力V.S.热阻&压缩率曲线图

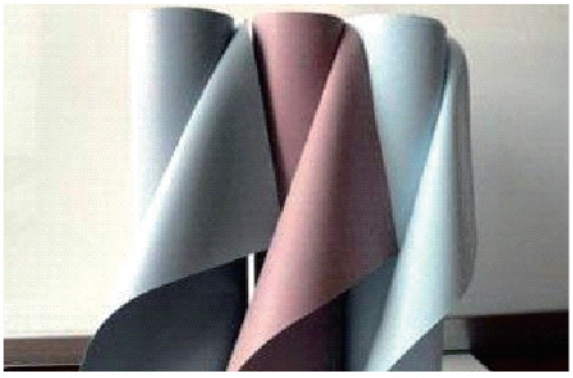


产品配置

- 标准尺寸为 整卷：宽*长*厚度 W305mm *L305mm
- 仓储最佳有效期：18个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

GSP-900

产品 外形及特点 Appearance and features



基本特性	典型值		测试标准
	GSP-900 G16	GSP-900 PI3	
颜色	粉色	黄色	目测
厚度（mm）	0.2	0.15	目测
基材	玻璃纤维	PI膜	N/A
密度（g/cm^3）	2.15	2.15	ASTM D792
硬度(Shore A)	85-90	85-90	ASTM D2240
拉伸强度Mpa	28	30	ASTM D412
击穿电压(KV)	>6	>6	ASTM D149
体积电阻率(Ω.cm)	5.4x10^{13}	2.3x10^{14}	ASTM D257
阻燃等级	V-0	V-0	UL 94
可持续工作温度（℃）	-40 to 180	-40 to 180	N/A
导热性能			
导热率(W/m-k)	1.6	1.3	ASTMD5470

热阻&压缩 v.s. 压力 （以G16，0.2mm样片为参考）

压力(Psi)	10	20	30	40	50	60	70
热阻(℃-in^2/W)	1.08	0.97	0.84	0.71	0.60	0.49	0.45
压缩比例（%）	7.0%	9.0%	11.0%	12.0%	13.0%	14.0%	15.0%

- 高导热，低热阻
- 导热系数1.3~1.6W/mk
- 高击穿电压，高强度
- UL94V0阻燃等级
- 低安装应力、易操作
- 玻纤及PI膜基材，可单面背胶

GSP-900系列是一款导热绝缘垫片材料，具有良好的绝缘性能和导热性能。

GSP-900 G16是在以玻璃纤维基材增强的导热硅橡胶而制成的导热绝缘片产品；

GSP-900 P13是以PI膜基材增强的导热硅橡胶而制成的导热绝缘片产品，同时具备导热性能和高耐压绝缘性能。主要应用于发热半导体器件和散热基板之间，起导热和绝缘作用。

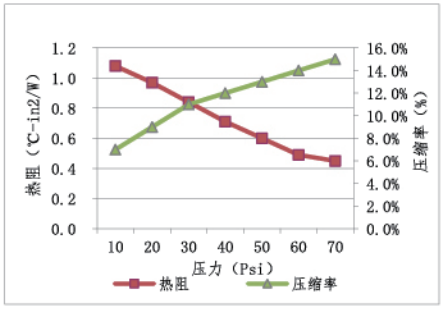
应用

- 通信设备
- 汽车部件
- 消费电子
- LED灯具
- 安防设备

操作说明

可依客户具体要求模切成所需要各类形状。各类应用的目标热源器件（通常是半导体器件，如电源标准器件：TO-220和TO-247等）在组装过程中绝大多数采用弹簧卡夹或螺钉安装，只要在组装过程中施加一个适当的安装所需要的力，使其固定在热源器件和散热板之间就可以实现有效的导热效果。

压力V.S.热阻&压缩率曲线图



产品配置

- 标准尺寸为 整卷：宽*长*厚度

  W305mm *L50m 也可根据顾客要求定制
- 仓储最佳有效期：18个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

GFP-200 单组份系列

高性能导热界面材料

良好导热率的导热胶水 | 良好的表面润湿性能 | 单组份

产品 外形及特点 Appearance and features



- 单组份导热凝胶，异性施工点胶
- 导热系数1.5~12W/mk
- 表面润湿性能佳、可压缩、低渗油
- 间隙填充能力佳，低热阻

基本特性		典型值					测试标准
	颜色	黄色	蓝/粉色	灰色	灰色	灰色	目测
	流速（g/min）	100-150	60-80	40-60	25-35	15-25	0.6Mpa/min (30cc出料 Φ2.54mm)
	密度（g/cm³）	2.2	2.9	3.1	3.2	3.4	ASTMD792
	长期使用温度（℃）	-40~150					NA
	最薄使用厚度（mm）	>0.1				0.3	90psi
	击穿电压（KV）	>5					ASTMD149
	体积电阻(Ω.cm)	1.6*1012					ASTMD257
	阻燃等级(UL)	VO					UL-94
	导热系数(W/mk)	2	3.5	6	8	12	ASTMD5470

热阻&压缩 v.s. 压力 （厚度1mm样片为参考）								
压力(Psi)	10	30	40	50	60	70	80	90
热阻(℃-in²/W)	0.80	0.73	0.69	0.65	0.63	0.62	0.61	0.60

GFP-200 S系列是一款膏状单组份的间隙填充高导热材料，不固化。耐高温，不易出油，可靠性高；是一种柔软且导热优良的弹性体，随结构形状成型；针对不平整的陶瓷、散热器表面或者不规则腔体，它具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性，缝隙填充充分。

应用

- 新能源汽车
- 通信设备
- 消费电子
- LED灯具
- 安防设备

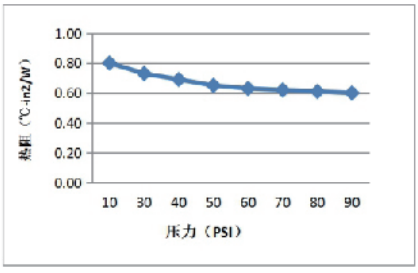
操作说明

（1）清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污；

（2）施胶：拧开胶管盖帽，安装合适的混合管，将胶挤到已清理干净的表面，使之分布均匀即可，使用点胶机或胶枪进行点胶；

注意事项：施胶完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

压力V.S.热阻&压缩率曲线图



产品配置

- 包装规格：30ml/支，300ml/支 20kg/桶也可客户要求订制包装。
- 仓储最佳有效期：6个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

GFP-200 K60S LV

低挥发高性能单组份导热胶水

高导热率的导热胶水丨良好的表面润湿性能丨单组份

产品 外形及特点 Appearance and features



- 低挥发单组份导热凝胶，异性施工点胶
- 导热系数6.0W/mk
- 表面润湿性能佳、可压缩、低渗油
- 间隙填充能力佳，低热阻

基本特性	典型值	测试标准
颜色	白色	目测
密度（g/cm3）	3.10	ASTMD792
流速（g/min）	40-60	0.6Mpa/min（30cc出料 Φ2.54mm）
长期使用温度（℃）	-40~150	NA
最薄使用厚度（mm）	>0.1	NA
击穿电压（KV）	>6	ASTMD149
D4-D12	<100 ppm	/
阻燃等级(UL)	VO	UL-94
导热系数(W/mk)	6.0	ASTMD5470

热阻&压缩 v.s. 压力 （厚度1mm样片为参考）					
压力(Psi)	10	20	30	40	50
热阻(℃-in²/W)	0.65	0.55	0.45	0.40	0.34

GFP-200 K60S系列是一款膏状的间隙填充高导热材料。是一种柔软且导热优良的弹性体，随结构形状成型；针对不平整的陶瓷、散热器表面或者不规则腔体，它具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性，缝隙填充充分。

应用

- 光模块
- 通信设备
- 消费电子
- LED灯具
- 安防设备

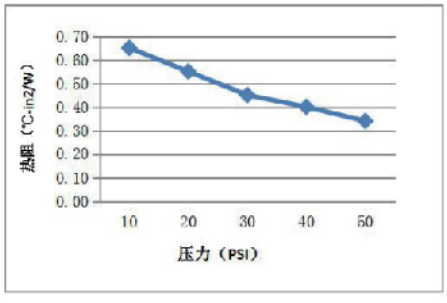
操作说明

（1）清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污；

（2）施胶：拧开胶管盖帽，安装合适的混合管，将胶挤到已清理干净的表面，使之分布均匀即可，使用点胶机或胶枪进行点胶；

注意事项：施胶完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

压力V.S.热阻&压缩率曲线图



产品配置

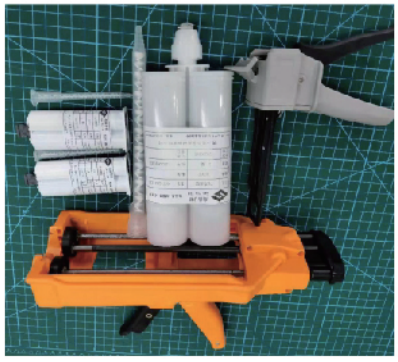
- 包装规格：30ml/支，300ml/支 20kg/桶也可客户要求订制包装。
- 仓储最佳有效期：6个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

GFP-200 双组份系列

高性能低密度双组份导热胶水

良好导热率的导热胶水 | 良好的表面润湿性能 | 低密度 双组份

产品 外形及特点 Appearance and features



- 1:1固化，可室温或加温固化
- 导热系数2.0~10W/mk，低密度
- 表面润湿性能佳、可压缩、低渗油
- 间隙填充能力佳，低热阻

基本特性		典型值					测试标准
		K20	K35	K50	K80	K100	目测
混合前	颜色	黄/白	蓝/白	灰/白	灰/白	灰/白	
	粘度（K*mpa.s）	140-200	250-300	350-450	450-550	550-650	ASTMD2196
	密度（g/cm³）	2.0	2.8	3	3.4	3.5	ASTMD792
	混合比例	1:1					NA
混合后	固化方式	室温或高温					NA
	表干时间H（25℃）	1-2					NA（可调）
	完全固化时间（25℃）	6-8					NA（可调）
	完全固化时间min（100℃）	4-8					NA（可调）
	长期使用温度（℃）	-40~150					NA
	硬度（Shore 00）	40-70					ASTMD2240
	击穿电压（KV）	>5					ASTMD149
	体积电阻（Ω.cm）	1.6*10的12次方					ASTMD257
	阻燃等级（UL）	VO					UL-94
	导热系数（W/mk）	2.0	3.5	5	8	10	ASTMD5470

热阻&压缩 v.s. 压力 （厚度1mm样片为参考）								
压力（Psi）	10	20	30	40	50	60	70	80
热阻（℃-m²/W）	0.00051	0.00044	0.00042	0.00039	0.00036	0.00035	0.00034	0.00033

GFP-200 系列是一款膏状的间隙填充导热材料。可在常温或高温条件下反应固化，固化产物是一种柔软且导热优良的弹性体，随结构形状成型；针对不平整的陶瓷、散热器表面或者不规则腔体，它具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性，缝隙填充充分。

应用

- 新能源汽车
- 通信设备
- 消费电子
- LED灯具
- 安防设备

操作说明

（1）清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污；

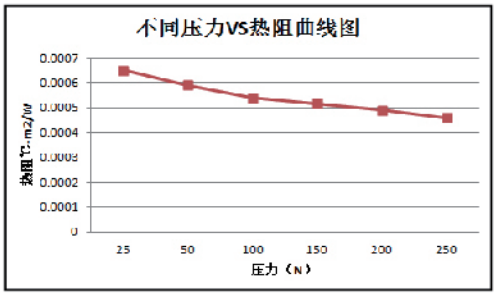
（2）施胶：拧开胶管盖帽，安装合适的静态混合管，将胶挤到已清理干净的表面，使之分布均匀即可，使用点胶机或胶枪进行点胶；

（3）固化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其室温固话或者加热高温固话都可。

注意事项：施胶完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

产品具有良好的绝缘耐压特性和温度稳定性，使用安全、可靠。

压力V.S.热阻&压缩率曲线图



产品配置

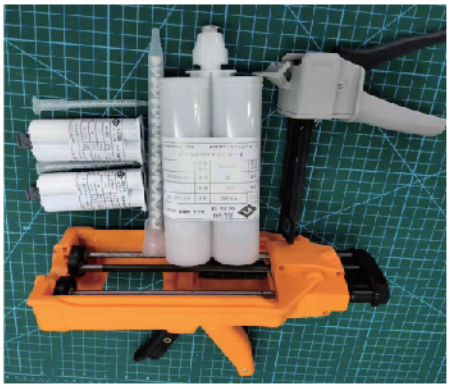
- 包装规格：400ml/支 20L/桶 200L/桶。
- 仓储最佳有效期：6个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

GFP-200 K20 Q

高性能低密度双组份导热胶水

良好导热率的导热胶水 | 良好的表面润湿性能 | 低密度 双组份

产品 外形及特点 Appearance and features



- 1:1固化，可室温或加温固化
- 导热系数2.0W/mk，低密度
- 表面润湿性能佳、可压缩、低渗油
- 间隙填充能力佳，低热阻

基本特性		典型值		测试标准
混合前		A组份	B组份	目测
	颜色	灰色	白色	
	粘度（K*mpa.s）	170-220	170-220	ASTMD2196
	密度（g/cm3）	2.0±0.2		ASTMD792
	混合比例	1:1		NA
混合后	固化方式	室温或高温		NA
	表干时间H(25℃)	≤1		NA（可调）
	完全固化时间(25℃)	6		NA（可调）
	完全固化时间min(100℃)	2		NA（可调）
	长期使用温度（℃）	-40-180		NA
	硬度（Shore 00）	50-60		ASTMD2240
	击穿电压（KV）	>6		ASTMD149
	体积电阻(Ω.cm)	1.6*1012		ASTMD257
	阻燃等级(UL)	VO		UL-94
	导热系数(W/mk)	2.0		ASTMD5470

热阻&压缩 v.s. 压力 （厚度1mm样片为参考）					
压力(Psi)	10	20	30	40	50
热阻(℃-m^2/W)	0.00051	0.00044	0.00042	0.00039	0.00036

GFP-200 K20 Q系列是一款膏状的间隙填充导热材料。可在常温或高温条件下反应固化，固化产物是一种柔软且导热优良的弹性体，随结构形状成型；针对不平整的陶瓷、散热器表面或者不规则腔体，它具备最优异的结构适用性和结构件表面贴服特性，缝隙填充充分。

GFP-200 K20 Q系列固化前，像硅脂一样施以压力就可以流动；固化后具有导热垫片等同的属性，在热循环的作用下也不会从界面上脱落下来。

应用

- 新能源汽车
- 通信设备
- 消费电子
- LED灯具
- 安防设备

操作说明

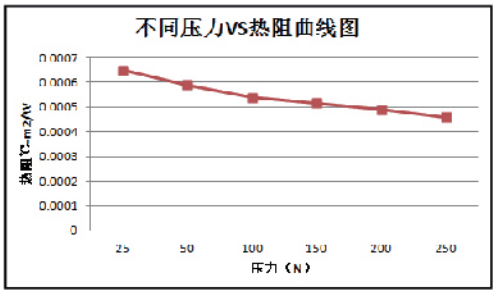
清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净，并除去锈迹、灰尘和油污；

施胶：拧开胶管盖帽，安装合适的静态混合管，将胶挤到已清理干净的表面，使之分布均匀即可，使用点胶机或胶枪进行点胶；

固化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其室温固话或者加热高温固话都可。

注意事项：施胶完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

压力V.S.热阻&压缩率曲线图



产品配置

- 包装规格：50ml/支，400ml/支 20kg/桶 也可客户要求订制包装。
- 仓储最佳有效期：6个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

GG-100系列导热硅脂

高性能导热界面材料

产品 外形及特点 Appearance and features



- 高导热，低热阻
- 导热系数1.0~7.0W/mk
- 触变性好，易操作
- 低沉降，优越的化学及机械稳定性
- 适用于丝网应刷，涂抹等工艺

基本特性	典型值					测试标准
	GG－100 K10	GG－100 K30	GG－100 K50	GG－100 K 70	GG－100 K5058	
颜色	白色	灰色	灰色	灰色	灰色	目测
粘度mpas*K	70~100	150~250	300~380	350~420	300~380	博勒飞
密度（g/cm^3）	2.35	2.9	3.2	3.3	3.1	ASTMD792
挥发率(%)24H@200℃	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	/
渗油率(%)24H@150℃	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	/
BLT	50μm	30μm	25μm	30μm	25微米	90psi
体积电阻率(Ω.cm)	5.4x10^{11}	2.3x10^{10}	2.3x10^{10}	2.3x10^{10}	2.3x10^{10}	ASTMD257
阻燃等级	V-0	V-0	V-0	V-0	V-0	UL 94
可持续工作温度(℃)	-40 to 180					N/A
导热性能						
导热率(W/m－k)	1.0	3.0	5.0	7.0	5.5	ASTMD5470
热阻&压缩 v.s. 压力 （以K10样片为参考）						
压力(Psi)	10	25	50	60	70	80
热阻(℃-in^2/W)	0.074	0.071	0.067	0.064	0.062	0.06

GG-100系列导热硅脂产品是用于高功率电子元件和散热片之间的导热硅脂。其优良的润湿性可使其迅速填充界面的微孔，极大程度降低界面热阻，可快速有效地降低电子原件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。

应用

- 通信设备
- 汽车部件
- 消费电子
- LED灯具
- 安防设备

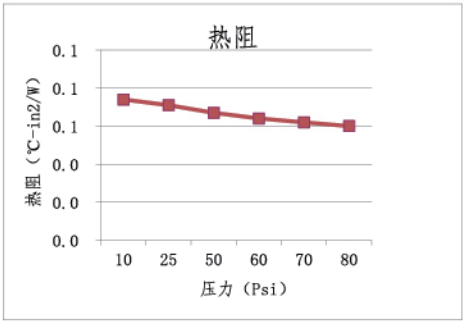
操作说明

1.涂抹前：散热器件一定需要清洁工作，后需要立即涂抹硅脂及安装，以免器件表面被氧化。建议长期放置的硅脂在使用前搅拌。

2.涂抹时：硅脂在充分涂抹情况下越薄越好，以完全覆盖器件表面为宜；如有挤出的硅脂擦净即可，每次使用完应密封以备后用。

3.如有沉降现象可搅拌均匀，仍可使用。

压力V.S.热阻&压缩率曲线图



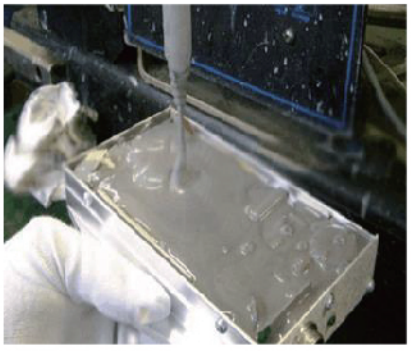
产品配置

- 罐装包装　包装规格：　重量：1Kg/罐
- 仓储最佳有效期：12个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

GFP-200 GF系列导热灌封胶

高性能导热界面材料

产品 外形及特点 Appearance and features



- 1:1使用可以100%固化
- 导热系数1.5~5.0W/mk
- 可室温固化或者加温固化
- 低沉降，优越的化学及机械稳定性
- 优异的流动性能
- 低密度、耐老化

基本特性	典型值						测试标准
	GFP-200 K15GF		GFP-200 K30GF		GFP-200 K50GF		
混合前组份	A	B	A	B	A	B	目测
颜色	黑色	白色	黑色	白色	黑色	白色	目测
粘度（mpas）	2000	2000	8000	8000	15500	15500	ASTMD2196
1: 1混合后性能							
粘度（mpas）	1500~2200		7000~9000		14500~17500		ASTMD2196
密度（g/cm）	1.5		2.9		3.1		ASTMD792
硬度（Shore A）	30~70		30~70		30~70		ASTMD 2240
阻燃等级（UL-94）	V-0		V-0		V-0		3mm 测试
腐蚀性	无		无		无		铜，铝材质
表干时间（H）@25℃	2		2		2		GP METHOD
固化时间（H）@25℃	5~8		5~8		5~8		
固化时间（H）@100℃	0.2~0.5		0.2~0.5		0.2~0.5		
体积电阻率（Ω.cm）	$5.4x10^{11}$		$2.3x10^{11}$		$2.3x10^{11}$		ASTMD257
可持续工作温度（℃）	-40 to 150						N/A
导热性能							
导热率（W/m-k）	1.5		3.0		5		ASTMD5470
热阻&压缩 v.s. 压力 （以k15样片为参考）							
压力（Psi）	10	25	50	60	70	80	90 100 70
热阻（$℃-in^2/W$）	1.52	1.40	1.28	1.20	1.16	1.13	1.11 1.09 0.45

GFP-200系列导热灌封胶是一种双组分硅胶材料。专门设计用于电子电气产品和模块的制造。该材料可在室温下或加热后固化，形成弹性导热和阻燃硅胶。采用手动方式或自动点胶方式操作。

应用

- 车载电子器件与PCB之间的连接固定
- 汽车电源模块的灌封保护
- 通讯器件
- 消费电子
- 变频器，传感器

操作说明

计量--搅拌--混胶搅拌--抽真空--灌封--常温静置(或加热)：

1.计量：称量A组份和B组份的重量比1:1；

2.搅拌：使用前需将容器底部与内壁都需要搅拌均匀；

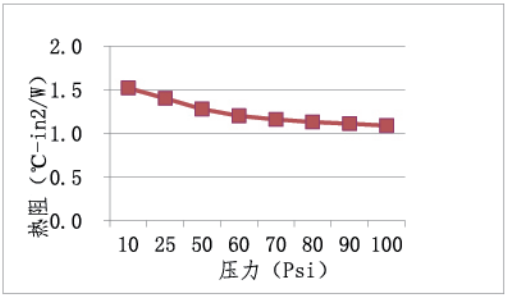
3.混胶搅拌：依照1:1比例混合,请在混料桶中沿一个方向搅拌，搅拌约5~10分钟后确保均匀即可；

4.抽真空：完全搅拌均匀后迅速移到真空箱内进行脱泡，搅拌时卷入的气泡会使液面上升，气泡破了后液面又会下降。真空度的大小以及抽真空时间，看胶水的粘度及产品的要求面定（脱泡时间一般为：3~5分钟)。如果没有真空机，搅拌均匀后将产品放置5~30分钟自动脱泡；

5.灌胶：注入必要的胶量、且注意不要卷入气泡。顺着外壳的内壁流入到底部后，让胶水液面慢慢升高，尽量避免将空气覆盖在里面；

6.常温/加热静置：灌封凝胶注入后在所定的固化条件（温度）下进行固化；

压力V.S.热阻&压缩率曲线图



产品配置

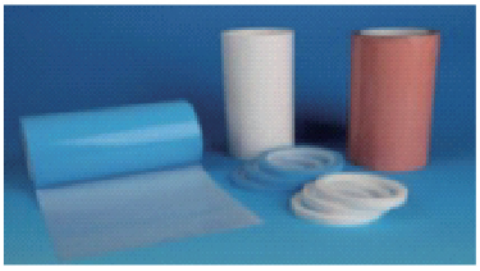
- 罐装包装

  包装规格： 重量：25Kg/桶
- 仓储最佳有效期：12个月
- 储藏条件：室温（25℃±3）、相对湿度RH<65%

GFP-300

高性能导热界面材料

产品 外形及特点 Appearance and features



- 柔软、易粘贴、易转移、耐热老化
- 粘接强度高
- 可模切成不同形状使用
- 优异的热传导

基本特性	单位	数值						测试标准
胶粘剂类型	---	亚克力胶黏剂						---
基材	---	玻璃纤维						---
颜色	---	白色						Visual
厚度	mm	0.15	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	ASTM D374
密度	g/cm³	1.8	1.9	2.05	2.09	2.12	2.16	ASTM D792
热阻	℃-in2/w	0.48	0.52	0.85	0.95	1.12	1.16	ASTM D5470
击穿电压	Kv	≥3	≥3.5	≥4.3	≥4.5	≥5	≥5	ASTM D149
剥离强度	g/in	≥1400						PSTC-1
保持力	25℃	48H						PSTC-7
耐温范围	℃	-40~120						EN344
阻燃等级	---	VO						UL-94
导热系数	W/m.k	1.0						ASTM D5470

GFD-300 是一种高性能丙烯酸压敏胶填充高导热陶瓷粒子涂布于玻璃纤维两面而制成的导热双面胶带；具有很好的导热性能，兼具柔软性、压缩性、服帖性、强粘性等特点。适应温度范围广，可填补不平整的表面，能紧密牢固地贴合热源器件和散热片，将热量快速传导出去导热性能高且稳定，其寿命比一般的散热双面贴纸长，常温（80-120度）下可工作最低5年。

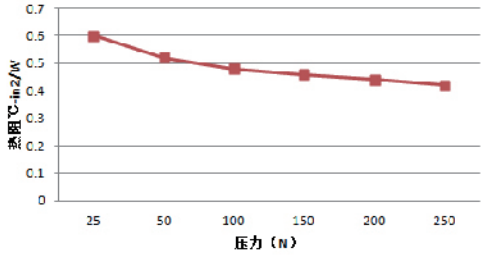
应用

- 车载电子器件与PCB之间的连接固定
- 汽车电源模块的灌封保护
- 通讯器件
- 消费电子
- 变频器，传感器

操作说明

可用于需要导热的其他装置的粘接，取代了用螺丝固定，可以达到最有效的散热效果，其粘接其它散热片与发热设备的用法也很便捷，将导热双面贴置于发热片与散热片之间，加力压紧，散热片即被牢牢固定在发热片上，其散热效果比一般的散热贴纸效果明显，大大提升了元件的寿命，是一些高端且需导热的电子产品的首选。

压力V.S.热阻&压缩率曲线图



产品配置

- 抗紫外线 UV： 中等
- 保质期：原封包装 12 个月，
- 在温度为 10-25℃、30-70%RH 贮存条件下

GAP-600 K30

产品介绍

本公司的 GAP-600 系列产品是由微米级片状铁基合金粉末与硅胶混合、分散、压制而成的软磁材料，无卤环保，吸波效果优异，可有效抑制IC芯片、天线等信号源与散热器、机箱等部件之间的电磁干扰。

产品实例



产品特性

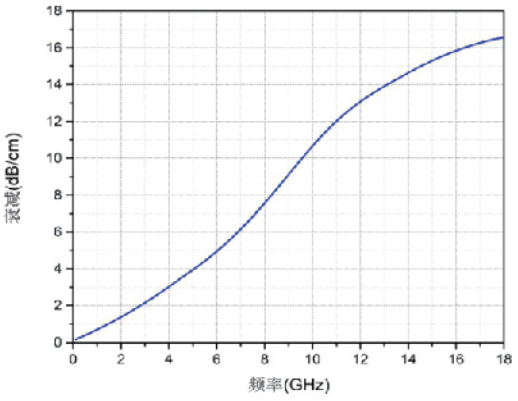
1. 优良的绝缘材料

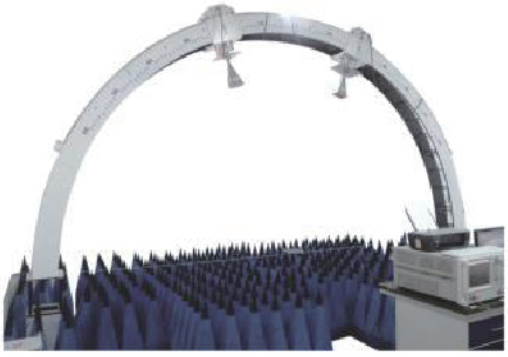
2. 优良的耐候性和柔韧性

3. 吸波及电磁屏蔽，表面兼容性好

4. 长期使用可靠性高

屏蔽效能





技术参数

测试项目	技术指标	单位	测试方法
屏蔽效能	测量数值请详见右图	dB/cm	GJB:2038-1994
硬度	60±5	ShoreA	ASTM D2240
密度	4.0±0.2	g/cm³	ASTM D792
导热系数	3.0±0.3	W/mK	ISO22007-2-2008
阻燃等级	V0	/	UL94
工作温度	-40~175	° C	-
出货规格	305*305(片材)	mm	-

产品符合 RoHS 和无卤

备注:数据表中包含的信息是为了帮助您设计和选择指南。它们并不能保证适用于所有应用程序，用户应确定每个应用的适合性。另外，在使用本产品之前，我们建议用户进行测试，判断该产品是否适合我们所要求的区域。我们保留所有的权利，包括版权，以及本文档的内容。未经本公司同意，严禁复制、重印及作其他用途。如果您需要更多的帮助，请联系我们。

GAP-600 K40

产品介绍

本公司的 GAP-600 系列产品是由微米级片状铁基合金粉末与硅胶混合、分散、压制而成的软磁材料，无卤环保，吸波效果优异，可有效抑制IC芯片、天线等信号源与散热器、机箱等部件之间的电磁干扰。

产品实例



产品特性

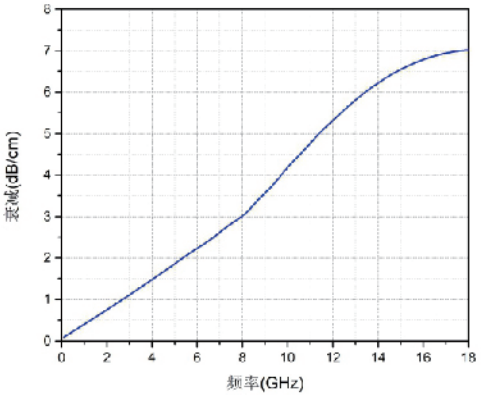
1. 优良的绝缘材料

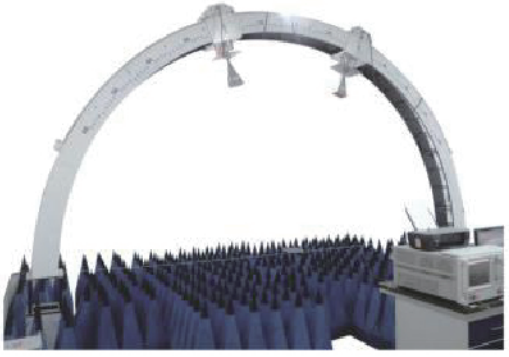
2. 优良的耐候性和柔韧性

3. 吸波及电磁屏蔽，表面兼容性好

4. 长期使用可靠性高

屏蔽效能





技术参数

测试项目	技术指标	单位	测试方法
屏蔽效能	测量数值请详见右图	dB/cm	GJB:2038-1994
硬度	60±5	ShoreOO	ASTM D2240
密度	3.8±0.2	g/cm³	ASTM D792
导热系数	4.0±0.4	W/mK	ISO22007-2-2008
阻燃等级	V0	/	UL94
工作温度	-40~175	° C	-
出货规格	305*305(片材)	mm	-

产品符合 RoHS和无卤

备注:数据表中包含的信息是为了帮助您设计和选择指南。它们并不能保证适用于所有应用程序，用户应确定每个应用的适合性。另外，在使用本产品之前，我们建议用户进行测试，判断该产品是否适合我们所要求的区域。我们保留所有的权利，包括版权，以及本文档的内容。未经本公司同意，严禁复制、重印及作其他用途。如果您需要更多的帮助，请联系我们。

佳 服务

利 客户

品 质优



◇ 汽车电子



◇ 5G 通信应用



◇ 安防



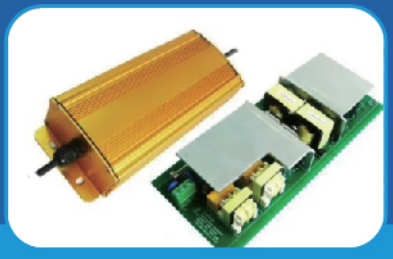
◇ 光学元器件

佳利品导热

Jia Li Pin TIM



◇ 汽车动力电池包



◇ 电源



◇ 消费电子穿戴设备

昆山佳利品导热材料有限公司

Kunshan Jia Li Pin Thermal Conductivity Materials Co. Ltd

江苏省苏州市昆山市周市镇金茂路598号

189 6263 4563

wl18962634563@163.com

www.jipdaore.com